

中国PCB行业现状深度分析与投资前景预测报告 (2026-2033年)

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国PCB行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/806695.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、钻针为PCB加工核心耗材，直接影响钻孔质量

印制电路板(Printed circuit board, PCB),是为各类电子系统提供元器件机械装配支撑和电气连接,同时承载电子设备信号传输、信号收发、电源供给的核心基础件,被称为“电子工业的基石”。

印制电路板过孔是实现内层互联和线路导通的核心组成单元,其结构复杂、密集度高,加工品质直接决定了印制电路板传输信号质量与传输能力。目前,印制电路板过孔加工主要采用机械钻孔和激光钻孔两种方法,其中机械钻削主要用于加工直径0.075mm及其以上的通孔与盲孔,激光钻孔常用于加工直径0.1mm以下的盲孔。机械钻孔具有激光钻孔不可替代的材料适用性广、孔深径比大、孔型好、孔质量高等优点,目前依然是印制电路板制孔的主流方法。

PCB孔结构示意图

资料来源:观研天下数据中心整理

PCB钻针是PCB机械钻孔工序的核心切削耗材,专用于在铜箔覆铜板上加工精密导通孔,以实现PCB层间电气互联。PCB钻针直径通常介于0.1mm到6.5mm之间,直径在0.2mm及以下的PCB钻针称为PCB微钻,可用于加工高精度PCB,钻针的直径越小,生产技术难度越大。通常结构上包含钻尖、钻柄、螺旋刀(退刃槽)三部分,一般根据PCB板的钻孔孔径来选择钻头直径。

PCB钻针结构

资料来源:公开资料、观研天下数据中心整理

二、全球PCB行业将保持快速增长, AI应用领域为推动PCB行业增长的核心动能

PCB作为钻针的下游应用领域,通常按照层数及技术特点来划分。PCB通常可划分为单/双层PCB、多层PCB、HDI

PCB、FPC及封装基板等多个品类,其中目前AI场景前沿应用主要以高多层PCB和HDI PCB为主。伴随AI服务器采用的高多层PCB和HDIPCB的持续升级(如层数增加和密度提升),其在加工制造环节也对钻针在量和质维度提出更高需求。

PCB种类划分及应用场景 PCB种类 特征 应用 单/双层PCB 单层PCB只在基板的一侧布有电路,常见于计算器、简单遥控器等简单电子设备。双层PCB两侧都有线路,通过金属化孔连接两侧的线路,满足中等稍复杂的电路需求。

简单家电、低端控制器、电脑周边、普通工业控制 多层PCB 多层PCB是指四层或以上的PCB,可以容纳更多电路层,提供更大布线空间以实现更高的电路密度,从而支持更复杂的功

能，并在有限空间内集成更多元件。多层PCB还可以按层数进一步划分为中低层PCB（四到六层）以及高多层PCB（八层及以上）通信设备、汽车电子、服务器 HDI PCB HDI PCB通过盲孔和埋孔技术提升布线密度，在有限空间内集成更多元件，还能帮助减少信号干扰和损耗。根据层数增加和工艺复杂度，HDI PCB可分为低阶HDI PCB、高阶HDI PCB和anylayer HDI PCB。智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 FPC FPC使用可弯曲的柔性基材制造，具有配线密度高、重量轻、弯折性好的特点，适用于形状特殊及空间受限的设备。

折叠屏手机、摄像头模组 封装基板 封装基板是连接裸芯片和外部电路的核心载体，为芯片提供电气连接、散热和保护，具有高密度、高精度、轻薄化的特点，是先进封装的关键环节。CPU、GPU、FPGA等高端芯片的封装

资料来源：观研天下数据中心整理

近年来，全球PCB行业呈现出比较稳定的增长趋势。按收入计算，全球PCB行业的市场规模从2020年的652亿美元增至2022年的817亿美元，复合年增长率为12.0%。到2023年，由于下游需求疲软，行业经历了短暂的低迷，市场规模从2022年的817亿美元降至695亿美元，同比下降15.0%。这一下降主要是由于全球宏观经济波动，包括通胀上升和地区地缘政治紧张局势，削弱了对下游终端产品的需求，从而减少了下游客户对PCB的采购。同时，下游行业库存水平上升也继续限制了对PCB产品的新订单。自2024年起，全球PCB行业开始从2023年的低迷中保持复苏势头。按销售收入计算，全球PCB行业市场规模从2023年的695亿美元增至2025年的852亿美元，2023年至2025年的复合年增长率为10.7%。复苏得益于下游需求逐渐好转、过剩库存的逐步消化以及数据基础设施投资的持续等因素，共同推动了PCB需求回暖。在汽车智能化和电动化升级加速、AI算力需求爆发等背景下在多重因素推动下，PCB作为电子设备的核心部件，市场需求预计将持续旺盛。以销售收入计，全球PCB行业的市场规模预计在2030年达到1233亿美元，2025年至2030年的复合年增长率为7.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在细分产品方面，自2024年起，全球PCB行业整体回暖，所有产品类型都实现了增长。按销售收入计算，2025年全球单/双层PCB、多层PCB、HDI PCB、FPC及封装基板的市场规模分别为84亿美元、331亿美元、158亿美元、129亿美元和149亿美元。下游应用领域的技术升级趋势推动了PCB行业的高端化转型，HDI PCB、封装基板等高技术壁垒和高附加值产品成为增长的主要动力。预计到2030年，按销售收入计算，全球单/双层PCB、多层PCB、HDI PCB、FPC及封装基板的市场规模将分别达到97亿美元、486亿美元、245亿美元、155亿美元和250亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从下游应用结构来看，自2024年起，全球PCB在所有应用领域的市场规模都有所增长，整个行业开始复苏，而且增长趋势会持续到2025年。2025年全球PCB市场在汽车电子、数据

基础设施、通信、智能设备和工业控制这五大主要应用领域的市场规模将分别达到97亿美元、181亿美元、101亿美元、398亿美元和32亿美元。得益于汽车智能化和电动化趋势带来的每辆车PCB用量和价值提升，以及AI算力需求爆发对服务器、交换机等设备PCB的强劲推动，预计到2030年，汽车电子和数据基础设施领域的PCB市场规模将分别达到130亿美元和364亿美元，2025年至2030年的复合年增长率分别为6.2%和15.0%。通信、智能设备和工业控制领域将保持稳健增长，预计2030年这三个应用领域的PCB市场规模将分别达到136亿美元、510亿美元和40亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、受下游PCB需求带动，钻针已进入高景气周期

近年来全球传统钻针行业维持稳步增长态势，市场规模从2020年的35亿元增长至2025年的60亿元，期间复合增长率为11.4%。未来在AI技术持续进步下，下游AI PCB行业将快速增长，预计将带动上游传统PCB钻针行业进入高增速周期，钻针市场规模预计将在2030年达到100亿元，期间复合增长率为10.8%。若进一步考虑传统钻针需求向高端钻针需求的迈进（如涂层钻针、PCD钻针或高长径比钻针，其具备更高的单针价值量），则钻针市场规模将触及更高维度。

数据来源：观研天下数据中心整理（wys）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国PCB行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需

数据引用案例请联系观研天下客服索取)

报告主要图表介绍

图(部分)

表(部分)

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势

行业所属行业流动资产分析

2021-2025年行业细分市场1市场规模

行业所属行业销售规模分析

2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测

行业所属行业负债规模分析

2021-2025年行业细分市场2市场规模

行业所属行业利润规模分析

2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测

所属行业产值分析

2021-2025年全球行业市场规模

所属行业盈利能力分析

2025年全球行业区域市场规模分布

所属行业偿债能力分析

2021-2025年亚洲行业市场规模

所属行业营运能力分析

2026-2033年亚洲行业市场规模预测

所属行业发展能力分析

2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况

2026-2033年北美行业市场规模预测

企业1主要经济指标分析

2021-2025年欧洲行业市场规模

企业1盈利能力分析

2026-2033年欧洲行业市场规模预测

企业1偿债能力分析

2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 PCB

第一节 PCB

一、PCB

二、PCB

三、PCB

四、PCB

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国 PCB

第三节 中国 PCB

第二章 中国 PCB

第一节 中国 PCB

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国 PCB

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对 PCB

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 中国 PCB

第一节 中国宏观经济发展现状

第二节 中国对外贸易环境与影响分析

第三节 中国 PCB

一、PEST模型概述

二、政策环境影响分析

三、经济环境影响分析

四、社会环境影响分析

五、技术环境影响分析

第四节 中国 PCB

第四章 全球 PCB

第一节 全球 PCB

第二节 全球	PCB	
一、2021-2025年全球		PCB
二、全球	PCB	
第三节 亚洲	PCB	
一、亚洲	PCB	
二、2021-2025年亚洲		PCB
三、亚洲	PCB	
第四节 北美	PCB	
一、北美	PCB	
二、2021-2025年北美		PCB
三、北美	PCB	
第五节 欧洲	PCB	
一、欧洲	PCB	
二、2021-2025年欧洲		PCB
三、欧洲	PCB	
第六节 2026-2033年全球		PCB
第七节 2026-2033年全球		PCB
【第三部分 国内现状与企业案例】		
第五章 中国	PCB	
第一节 中国	PCB	
一、	PCB	
二、	PCB	
第二节 中国	PCB	
一、影响中国	PCB	
二、2021-2025年中国		PCB
三、中国	PCB	
第三节 中国	PCB	
一、2021-2025年中国		PCB
二、中国	PCB	
第四节 中国	PCB	
一、2021-2025年中国		PCB
二、中国	PCB	
第五节 中国	PCB	
第六章 中国	PCB	
第一节 中国	PCB	

行业发
行业技

行

第二节	PCB
一、	PCB
二、	PCB
三、2021-2025年中国	PCB
第三节	PCB
一、	PCB
二、	PCB
第四节 中国	PCB
一、需求偏好	
二、价格偏好	
三、品牌偏好	
四、其他偏好	
第五节 中国	PCB
第七章 中国	PCB
第一节 中国	PCB
一、产业链模型原理介绍	
二、产业链运行机制	
三、	PCB
第二节 中国	PCB
一、上游产业发展现状	
二、上游产业对	PCB
三、下游产业发展现状	
四、下游产业对	PCB
第三节 中国	PCB
一、中国	PCB
二、细分市场分析——市场1	
1. 2021-2025年市场规模与现状分析	
2. 2026-2033年市场规模与增速预测	
三、细分市场分析——市场2	
1.2021-2025年市场规模与现状分析	
2. 2026-2033年市场规模与增速预测	
(细分市场划分详情请咨询观研天下客服)	
第八章 中国	PCB
第一节 中国	PCB
一、中国	PCB

二、中国	PCB
第二节 中国	PCB
一、中国	PCB
二、中国	PCB
第三节 中国	PCB
一、企业区域分布特征	
二、企业规模分布特征	
三、企业所有制分布特征	
第四节 中国	PCB
一、波特五力模型原理	
二、供应商议价能力	
三、购买者议价能力	
四、新进入者威胁	
五、替代品威胁	
六、同业竞争程度	
七、波特五力模型分析结论	
第九章 中国	PCB
第一节 中国	PCB
一、企业数量结构分析	
二、行业资产规模分析	
第二节 中国	PCB
一、流动资产	
二、销售收入分析	
三、负债分析	
四、利润规模分析	
五、产值分析	
第三节 中国	PCB
一、行业盈利能力分析	
二、行业偿债能力分析	
三、行业营运能力分析	
四、行业发展能力分析	
第十章 中国	PCB
第一节 中国	PCB
一、影响	PCB
二、中国	PCB

第二节 中国华东地区	PCB	
一、华东地区概述		
二、华东地区经济环境分析		
三、华东地区	PCB	
1、2021-2025年华东地区		PCB
2、华东地区	PCB	
3、2026-2033年华东地区		PCB
第三节 华中地区市场分析		
一、华中地区概述		
二、华中地区经济环境分析		
三、华中地区	PCB	
1、2021-2025年华中地区		PCB
2、华中地区	PCB	
3、2026-2033年华中地区		PCB
第四节 华南地区市场分析		
一、华南地区概述		
二、华南地区经济环境分析		
三、华南地区	PCB	
1、2021-2025年华南地区		PCB
2、华南地区	PCB	
3、2026-2033年华南地区		PCB
第五节 华北地区市场分析		
一、华北地区概述		
二、华北地区经济环境分析		
三、华北地区	PCB	
1、2021-2025年华北地区		PCB
2、华北地区	PCB	
3、2026-2033年华北地区		PCB
第六节 东北地区市场分析		
一、东北地区概述		
二、东北地区经济环境分析		
三、东北地区	PCB	
1、2021-2025年东北地区		PCB
2、东北地区	PCB	
3、2026-2033年东北地区		PCB

第七节 西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区 PCB
- 1、2021-2025年西南地区 PCB
- 2、西南地区 PCB
- 3、2026-2033年西南地区 PCB

第八节 西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区 PCB
- 1、2021-2025年西北地区 PCB
- 2、西北地区 PCB
- 3、2026-2033年西北地区 PCB

第九节 2026-2033年中国 PCB

第十一章 PCB

第一节 企业1

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国 PCB

第一节 中国 PCB

第二节 2026-2033年中国 PCB

第三节 2026-2033年中国 PCB

一、2026-2033年中国 PCB

二、2026-2033年中国 PCB

三、2026-2033年中国 PCB

第四节 2026-2033年中国 PCB

一、2026-2033年中国 PCB

二、2026-2033年中国 PCB

第五节 2026-2033年中国 PCB

第六节 2026-2033年中国 PCB

第十三章 中国 PCB

第一节 观研天下中国 PCB

一、未来 PCB

二、未来 PCB

第二节 中国 PCB

第三节 中国 PCB

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国 PCB

第四节 中国 PCB

第五节 中国 PCB

第六节 观研天下中国 PCB

第十四章 中国 PCB

第一节 中国 PCB

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第二节 中国 PCB

一、 PCB

行

- 二、PCB
- 三、PCB
- 四、PCB
- 五、PCB
- 第三节 PCB
- 一、PCB
- 二、PCB
- 三、PCB
- 四、PCB

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/806695.html>